



2023年5月期 第3四半期決算短信〔日本基準〕(非連結)

2023年3月31日

上場会社名 三益半導体工業株式会社 上場取引所 東
 コード番号 8155 URL <https://www.mimasu.co.jp/>
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 細谷 信明
 問合せ先責任者 (役職名) 専務取締役管理本部担当 (氏名) 八高 達郎 (TEL) 027-372-2011
 四半期報告書提出予定日 2023年4月14日 配当支払開始予定日 —
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 2023年5月期第3四半期の業績(2022年6月1日～2023年2月28日)

(1) 経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
2023年5月期第3四半期	69,199	27.0	9,812	49.4	9,721	47.4	6,731	49.0
2022年5月期第3四半期	54,506	—	6,568	35.3	6,595	37.0	4,518	37.1

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり四半期純利益
	円 銭	円 銭
2023年5月期第3四半期	209.54	—
2022年5月期第3四半期	140.64	—

(注)「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日)等を前事業年度の期首から適用しており、2022年5月期第3四半期に係る各数値につきましては、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。なお、当該会計基準等の適用により大きな影響の生じる2022年5月期第3四半期の売上高は、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

(2) 財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
2023年5月期第3四半期	117,681	75,539	64.2
2022年5月期	104,280	70,602	67.7

(参考)自己資本 2023年5月期第3四半期 75,539百万円 2022年5月期 70,602百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
2022年5月期	—	19.00	—	26.00	45.00
2023年5月期	—	32.00	—		
2023年5月期(予想)				32.00	64.00

(注)直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 2023年5月期の業績予想(2022年6月1日～2023年5月31日)

(%表示は、対前期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
通期	85,000	14.2	11,000	45.6	11,000	45.4	7,500	46.3	233.47

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 無

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

- ① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 無
- ② ①以外の会計方針の変更 : 無
- ③ 会計上の見積りの変更 : 無
- ④ 修正再表示 : 無

(3) 発行済株式数(普通株式)

① 期末発行済株式数(自己株式を含む)	2023年5月期3Q	35,497,183株	2022年5月期	35,497,183株
② 期末自己株式数	2023年5月期3Q	3,373,103株	2022年5月期	3,372,572株
③ 期中平均株式数(四半期累計)	2023年5月期3Q	32,124,373株	2022年5月期3Q	32,124,758株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手している情報及び合理的であると判断する前提に基づいたものであり、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等につきましては、添付資料2ページ「1. 当四半期決算に関する定性的情報 (3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報	2
(1) 経営成績に関する説明	2
(2) 財政状態に関する説明	2
(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明	2
2. 四半期財務諸表及び主な注記	3
(1) 四半期貸借対照表	3
(2) 四半期損益計算書	5
(3) 四半期財務諸表に関する注記事項	6
(継続企業の前提に関する注記)	6
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)	6
(セグメント情報)	6

1. 当四半期決算に関する定性的情報

(1) 経営成績に関する説明

当第3四半期累計期間におけるわが国経済は、世界的な資源価格高騰などの影響を受けたものの、新型コロナウイルス感染症の抑制と社会経済活動の両立が進む中で、全体として緩やかな回復基調となりました。

当社の主要なユーザーである半導体関連各社の設備投資は、引き続き堅調に推移しました。また半導体シリコンウエハの生産は、デバイス市場における在庫調整の影響を受けました。

このような経営環境の中で当社は、最先端加工技術の推進と低コスト化の両立を図るとともに、自社開発製品の拡販を積極的に進めるなど、総力を挙げて業績の向上に取り組みました。

この結果、当第3四半期累計期間の売上高は691億9千9百万円と前年同四半期比27.0%の増収となり、営業利益は98億1千2百万円(前年同四半期比49.4%増)、経常利益は97億2千1百万円(同47.4%増)、四半期純利益は67億3千1百万円(同49.0%増)となりました。

セグメント別の経営成績は、次のとおりであります。なお、売上高及び利益には、セグメント間の内部取引に係る金額が含まれております。

半導体事業部

当事業部におきましては、300mmウエハ(再生ウエハを含む)を中心に生産は概ね堅調に推移いたしました。そうした中で、更なる品質の向上と原価低減を推進いたしました。

この結果、当事業部の売上高は414億2千2百万円(前年同四半期比15.5%増)、セグメント利益(営業利益)は76億7千1百万円(同40.7%増)となりました。

産商事業部

当事業部は自社開発製品及びその他の取扱商品の拡販活動に積極的に取り組みました。

この結果、自社開発製品及びその他の取扱商品ともに増収となり、当事業部の売上高は282億3千4百万円(前年同四半期比48.4%増)、セグメント利益(営業利益)は16億9千1百万円(同93.7%増)となりました。

エンジニアリング事業部

当事業部は開発部門としての役割に特化し、自社製品の開発を積極的に行い、産商事業部を通じて販売いたしました。

また、半導体事業部で使用する装置の開発や設計・製作にも意欲的に取り組みました。

この結果、当事業部の売上高は57億7百万円(前年同四半期比63.8%増)、セグメント利益(営業利益)は7億5千3百万円(同67.7%増)となりました。

(2) 財政状態に関する説明

当第3四半期会計期間末における総資産は、売上債権の増加等により、前事業年度末と比較して134億1百万円増加し、1,176億8千1百万円となりました。一方、負債合計は仕入債務の増加等により84億6千4百万円増加し、421億4千2百万円となりました。純資産合計は利益剰余金の増加48億6千8百万円等により、755億3千9百万円となりました。

(3) 業績予想などの将来予測情報に関する説明

業績予想につきましては、2022年9月30日に公表いたしました業績予想に変更はございません。

2. 四半期財務諸表及び主な注記

(1) 四半期貸借対照表

(単位：百万円)

	前事業年度 (2022年5月31日)	当第3四半期会計期間 (2023年2月28日)
資産の部		
流動資産		
現金及び預金	25,326	25,934
受取手形及び売掛金	37,060	45,260
商品及び製品	1,101	3,136
仕掛品	1,695	1,495
原材料及び貯蔵品	2,861	3,707
その他	1,668	1,048
貸倒引当金	△4	△5
流動資産合計	69,709	80,577
固定資産		
有形固定資産		
建物(純額)	20,381	19,293
機械及び装置(純額)	4,794	5,637
その他(純額)	5,246	7,133
有形固定資産合計	30,422	32,065
無形固定資産	858	754
投資その他の資産	3,291	4,284
固定資産合計	34,571	37,104
資産合計	104,280	117,681
負債の部		
流動負債		
支払手形及び買掛金	24,122	31,008
未払法人税等	2,930	2,307
引当金	162	598
その他	5,911	7,781
流動負債合計	33,126	41,696
固定負債		
退職給付引当金	385	279
その他	165	166
固定負債合計	551	445
負債合計	33,677	42,142

(単位：百万円)

	前事業年度 (2022年5月31日)	当第3四半期会計期間 (2023年2月28日)
純資産の部		
株主資本		
資本金	18,824	18,824
資本剰余金	18,778	18,778
利益剰余金	37,710	42,578
自己株式	△4,770	△4,772
株主資本合計	70,541	75,408
評価・換算差額等		
その他有価証券評価差額金	112	135
繰延ヘッジ損益	△51	△4
評価・換算差額等合計	61	130
純資産合計	70,602	75,539
負債純資産合計	104,280	117,681

(2) 四半期損益計算書
(第3四半期累計期間)

(単位：百万円)

	前第3四半期累計期間 (自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)	当第3四半期累計期間 (自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)
売上高	54,506	69,199
売上原価	44,166	52,346
売上総利益	10,340	16,853
販売費及び一般管理費	3,772	7,040
営業利益	6,568	9,812
営業外収益		
受取利息	1	1
受取配当金	10	12
為替差益	15	31
受取保険金	20	—
その他	31	32
営業外収益合計	79	77
営業外費用		
支払利息	0	0
固定資産除売却損	51	168
その他	0	0
営業外費用合計	51	168
経常利益	6,595	9,721
特別損失		
減損損失	45	—
特別損失合計	45	—
税引前四半期純利益	6,550	9,721
法人税、住民税及び事業税	2,340	3,947
法人税等調整額	△307	△956
法人税等合計	2,032	2,990
四半期純利益	4,518	6,731

(3) 四半期財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

前第3四半期累計期間(自 2021年6月1日 至 2022年2月28日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	35,854	18,652	—	54,506	—	54,506
セグメント間の内部売上高 又は振替高	1	368	3,485	3,854	△3,854	—
合計	35,855	19,020	3,485	58,361	△3,854	54,506
セグメント利益	5,451	873	449	6,773	△205	6,568

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3 エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行うため外部顧客への売上高は発生していません。

当第3四半期累計期間(自 2022年6月1日 至 2023年2月28日)

(単位:百万円)

	報告セグメント				調整額	四半期 損益計算書 計上額
	半導体事業部	産商事業部	エンジニア リング事業部	計		
売上高						
外部顧客への売上高	41,419	27,779	—	69,199	—	69,199
セグメント間の内部売上高 又は振替高	2	454	5,707	6,165	△6,165	—
合計	41,422	28,234	5,707	75,364	△6,165	69,199
セグメント利益	7,671	1,691	753	10,117	△304	9,812

(注) 1 セグメント利益の調整額は、セグメント間取引消去であります。

2 セグメント利益は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。

3 エンジニアリング事業部は開発部門としての役割に特化しており、販売に関しては産商事業部を通じて行うため外部顧客への売上高は発生していません。